

【プログラム】

- 13:00～13:20 「3DHI会員状況ご説明及び技術研究組合のご説明」 3DHI事務局長 島内 秀 氏
- 13:20～13:50 「3DHI のこれからについて」 3DHI 代表 井上 史大 氏
- 13:50～14:50 「高密度パッケージ内の樹脂界面を高信頼化する表面処理および研磨技術」
3DHI 理事長 齊藤 丈靖 氏
- 14:50～15:20 「LSTCの現状と方向」 大阪大学特任教授 菅沼 克昭 氏
- 15:20～15:35 休憩
- 15:35～16:35 「成長拡大する半導体アプリケーションと先端企業動向」
株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業部
グローバル製造業コンサルティング部 エキスパート 岸本 隆正 氏
- 16:35～17:35 「CMOSイメージセンサの進化を支える3D積層プロセス技術」
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
第2研究部門 部門長 岩元 勇人 氏
- 17:35～17:50 全体Q&A